

2026 초광역 성장엔진 인재육성사업

Semi-SEED Alliance

학생 참여 의향 조사 안내

반도체 인재양성 프로그램, 여러분의 의견을 들려주세요

5개 대학

대구대·성균관대·한양ERICA·조선대·한림대

4개 광역

경북·경기·강원·광주

L1~L5

SEED-Track 5단계 인증체계

Semi-SEED Alliance, 어떤 사업인가요?

행정구역을 넘어, 5개 대학이 연합해 만드는 반도체 인재양성 프로그램

경북·경기·강원·광주 4개 광역의 5개 대학이 힘을 합쳐, 기업이 원하는 실무 역량을 갖춘 반도체 인재를 함께 키워내는 초광역 인재양성 컨소시엄입니다.

SEED = Semiconductor Ecosystem for Engineering Development

국내 최초

대학·기업·연구소·교육기업
4자 통합 협의체

기업 인증권

L3부터 기업이 직접
교육 스펙·심사 참여

완결형 밸류체인

설계~소부장까지
6대 트랙 전 과정 커버

자립형 모델

SEED Holdings 등
사업 종료 후 자립 운영

학생 입장에서는 — 여러 대학의 강의·실습·인증을 넘나들며, 기업이 인정하는 실무형 커리어를 준비할 기회입니다.

참여하면 어떤 혜택이 있나요?

1

장학금

L2 이상 이수자 학기당 100만원
4년 최대 800만원 지급

2

채용 우대

L3 이상 취득 시 협약기업
100개사+ 우선채용 트랙
(서류·1차면접 면제)

3

학점 인정

L2 이수 = 3학점
L3 이수 = 6학점
정규 학점으로 자동 인정

4

국제 인증

Open Badge 3.0 기반
국제 표준 디지털 배지
(해외 취업·유학에도 활용)

95%

다. 학생 자발적 참여율 목표 — 장학금·채용우대·학점인정·국제인증이 결합된 만큼, 참여할수록 이득이 커지는 구조입니다.

SEED-Track 5단계 인증체계



GAME CHANGER L3부터는 기업이 직접 스펙을 정의하고 심사에 참여합니다 — 졸업 후 재교육 없이 바로 실무에 투입될 수 있는 실력을 인정받는 것입니다.

※ 참여 학년·전공에 따라 시작 레벨이 다를 수 있으며, 저학년은 L1~L2, 3~4학년은 L3(SEED-Track) 중심으로 참여합니다.

6대 반도체 트랙 & 참여대학 특화분야

1 설계

성균관대 · 대구대

AI·SoC·MPW

2 소자·공정

성균관대 · 한양대 ERICA

FinFET·GAA·Fab

3 패키징·후공정

조선대

HBM·2.5D/3D

4 분석·테스트

조선대 · 한양대 ERICA

실장·신뢰성 분석

5 장비

한림대

증착·식각·CMP

6 소부장

한림대 · 대구대

소부장 국산화

설문조사, 왜 참여해야 하나요?

이번 설문은 여러분의 참여 의향과 희망 분야를 파악해, 실제 교육과정·장학·인턴십 설계에 그대로 반영하기 위한 것입니다.

Q

무엇을 물어보나요?

참여 의향, 희망 트랙 분야(설계·소자공정·패키징·분석테스트·장비·소부장), 희망 이수 수준(L2/L3), 필요한 지원사항 등

T

얼마나 걸리나요?

약 5분 내외 (객관식 위주, 서술형 최소화)

!

왜 중요한가요?

응답이 많을수록 여러분이 원하는 과목·장학·인턴십 기회가 실제 프로그램에 반영될 가능성이 커집니다

참여 방법 소속 대학 공지 채널(학과 홈페이지·이메일·SNS)로 안내되는 설문 링크(QR)를 통해 응답해 주세요.

여러분의 한 표가 반도체 인재양성의 미래를 만듭니다

설문 참여, 지금 시작해 주세요